

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 3 日 (03.03.2005)

PCT

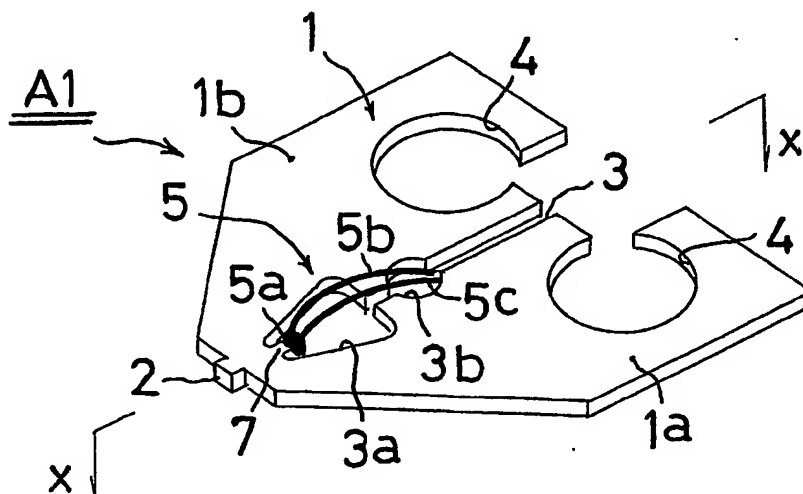
(10) 国際公開番号
WO 2005/018861 A1

- (51) 国際特許分類: B23K 3/047 (74) 代理人: 松波 祥文 (MATSUNAMI, Yoshifumi); 〒4600012 愛知県名古屋市中区千代田二丁目 1 9 番 4 号 松波特許事務所内 Aichi (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004008
- (22) 国際出願日: 2004 年 3 月 24 日 (24.03.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2003-299002 2003 年 8 月 22 日 (22.08.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 工房 P D A (KOBO PDA CO., LTD.) [JP/JP]; 〒4890962 愛知県瀬戸市大坪町 1 8 2 - 1 Aichi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石井 達也 (ISHII, Tatsuya) [JP/JP]; 〒4890962 愛知県瀬戸市大坪町 1 8 2 - 1 株式会社 工房 P D A 内 Aichi (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

[続葉有]

(54) Title: HEATER CHIP FOR THERMOCOMPRESSSION BONDING

(54) 発明の名称: 熱圧着用のヒーターチップ



(57) Abstract: A heater chip for thermocompression bonding, where the degree of heating at a thermocompression bonding part does not vary among individual heater chips and durability is enhanced. In a heater chip for thermocompression bonding, a small projection-like thermocompression bonding portion (2) heating up by conduction resistance is provided on a small plate-like body (1), on the head end side having a reduced width. A cut (3) is provided in the body, from the base end side toward the vicinity of the thermocompression bonding portion. Each of both sides of the cut serves as a conducting terminal portion (1a, 1b). A thermocouple (5) for temperature detection is installed in the vicinity of the thermocompression bonding portion (2). A projection portion (7) for thermo-welding a temperature detection portion of the thermocouple is provided on an inner side surface of the cut or on the outer peripheral side surface of the body.

[続葉有]



NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約:

個々のヒータチップ毎に、加熱圧接部の発熱度合いにはバラツキが生じず、かつ、耐久性も向上させた熱圧着用のヒータチップを提供する。

小板片状の本体（１）の、横幅の狭まった先端側に、通電抵抗により発熱する小突起状の加熱圧接部（２）を設け、基端側から、加熱圧接部の近傍に向けて切れ目（３）を設け、その両側部分のそれぞれを通電用端子部（１a，１b）とし、加熱圧接部（２）の近傍に、検温用のサーモカップル（５）を取り付けた熱圧着用のヒータチップにおいて、サーモカップルの検温部を熱溶着させるための溶着用突起部（７）を、切れ目の内側側面、または本体の外周側面に突設した。